

# スライス厚:70 $\mu$ m 極薄スライスを実現!

## 半導体パッケージ用放熱シート向け チャック式スライサー

# CH-1

### 連続的に!

専用設計されたチャックボックスを用いて  
ワークを確実に固定、連続スライスを実現します。

### 極薄スライス実現!

スライス厚:70 $\mu$ mを実現しました。  
その先の50 $\mu$ m厚も。

### 高精度で!

サーボモーターを駆使したトルク制御と  
専用刃物の自在な調整により  
厚み精度 $\pm$ 10%を実現します。

### 半導体用放熱シート製造に特化した 樹脂ブロックスライス専用スペック!

放熱シートの研究開発から生産まで  
革命を起こします

スライサー型式:CH-1 基本仕様

- スライス厚み:70~1,000 $\mu$ m  
(個別対応で最大2,000 $\mu$ mまで可能)
- ワークサイズ:50x50mm~150x150mm程度  
(サイズ別チャックBOXが必要です)
- ワーク特性・設定条件ごとに個別のスライスレシピの  
複数登録が可能。  
多種多様な放熱シートの開発・生産に寄与します。

特許取得済み  
特許番号:第7281813号  
発明の名称:"切削及び切削方法"



サンプル試作も  
随時承っております!



クラフトニクスとは、日本人の持つ伝統的な職人技=「クラフトマンシップ」と、  
最先端の技術=「メカトロニクス」を融合させ、高付加価値でありながら、  
こだわりの職人技を感じられるテクノロジーを意味する、丸仲鐵工所の登録商標です。

クラフトニクス® (登録商標)

2024年で創業90周年を迎えます

**MARUNAKA TEKKOSHO INC.**

株式会社 丸仲鐵工所

製造元 株式会社丸仲鐵工所

〒421-0111 静岡県静岡市駿河区丸子新田175-1

With Industry Since 1901  
**MORITANI**  
ISO14001 (Head Office, Osaka & Nagoya)

販売元 株式会社守谷商会

〒103-8680 東京都中央区八重洲1-4-22 機械10部第1課 担当:徳永 直人  
TEL.03-3278-6975 Mail: tokunaga.naoto@moritani.co.jp

出展します

第25回 半導体・センサ パッケージング展

半導体後工程の専門展 **ISP**

会期:2024年1月24日(水)~26日(金)

会場:東京ビッグサイト

展示場所:第4ホール E29-30